

**Toshiba stellt auf der embedded world 2019 eine Reihe neuer Produkte und Technologien vor**

*Demos zu Gigabit-Ethernet-Anbindung in Fahrzeugen und neue Antriebssteuerungslösungen werden in Halle 3A am Stand 424 gezeigt*

**Düsseldorf, 07. Februar 2019** – Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) wird auf der embedded world 2019 vom 26. bis 28. Februar in Nürnberg eine Vielzahl neuer Produkte und herausragender Technologien präsentieren, wie z.B. ein Gigabit-Ethernet-Bridge-IC für Automotive-Anwendungen, der AVB/TSN unterstützt; neue Antriebssteuerungslösungen für Schrittmotoren und einer Lösung, mit der sich die Markteinführung von ASIC-Designs verkürzen und deren Kosten verringern lassen.

Über schnellere Netzwerklösungen im Automobil können Besucher am Stand mehr Details zum Ethernet-AVB/TSN-Bridge-IC TC9562XBG erhalten. Der Baustein unterstützt die Echtzeit-Netzwerkanforderungen heutiger vernetzter Fahrzeuge und Fahrerassistenzsysteme (ADAS) mit einer Übertragungsrate von bis zu 1Gbit/s. Er erfüllt nicht nur die Ethernet-AVB-Spezifikation, sondern auch den TSN-Standard, wodurch er sich auch für industrielle Anwendungen eignet. Um eine Vielzahl von Ethernet-PHYs und Switches zu unterstützen, bietet der TC9562XBG MII, RMII, RGMII sowie SGMII.

Der Schrittmotortreiber TB67S128FTG zielt ebenfalls darauf ab, Strom zu sparen und dabei gleichzeitig eine präzise Steuerung zu garantieren. Der Baustein unterstützt 1/128-Mikroschritte und eignet sich damit für unterschiedliche Anwendungen wie 3D-Drucker, Geldautomaten und Haushaltsgeräte, während er gleichzeitig die Geräuschentwicklung verringert. Die AGC-Technologie (Active Gain Control) von Toshiba optimiert den Antriebsstrom entsprechend dem erforderlichen Drehmoment des Motors, verhindert mögliche Blockaden während des Betriebes und ermöglicht gleichzeitig Energieeinsparungen. Das erforderliche Drehmoment wird durch eine Ansteuerung mit hohem Strom (50V/5A) bereitgestellt, während der geringe Durchlasswiderstand (0,25Ω) die Wärmeentwicklung auf ein Minimum reduziert.

Interessante Details können über den kürzlich angekündigten FFSA™-Halbleiterfertigungsprozess (Fit Fast Structured Array) erfahren. Der neue 130nm-FFSA-Prozess, der vor allem auf industrielle Anwendungen abzielt, erweitert das derzeitige Angebot von Toshibas 28-, 40- und 65nm-Prozessen um eine weitere Option für industrielle Anwendungen. Der 130nm-Prozess bietet verschiedene Master-Slices für bis zu 664KB RAM und etwa 912.000 Gates pro Baustein.

Die embedded world 2019 findet vom 26. bis 28. Februar in Nürnberg statt. Toshiba\* befindet sich in Halle 3A am Stand 424. Dort steht ein Experten-Team zur Verfügung, um neue und vorhandene Produkte zu erläutern sowie technische Fragen zu beantworten.

###

## **Anmerkung für Redaktionen:**

\*embedded world 2019: Toshiba Memory Europe GmbH stellt gemeinsam mit Toshiba Electronics Europe GmbH aus.

## **Über Toshiba Electronics Europe**

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) ist der europäische Geschäftszweig für elektronische Komponenten [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#). TEE bietet europäischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lösungen für Automotive, Industrie IoT, Motor Control, Telekommunikation und Netzwerktechnik oder für Endverbraucher- und Haushaltsgeräte-Applikationen. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, optische Halbleiter, ASICs, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

Zum Hauptsitz in Düsseldorf gehören Zweigstellen in Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien. Von dort aus werden Design, Marketing und Vertrieb bereitgestellt. Präsident des Unternehmens ist Mr. Tomoaki Kumagai.

Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com).

## **Ansprechpartner für Veröffentlichungen:**

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

E-mail: [discrete-ic@toshiba-components.com](mailto:discrete-ic@toshiba-components.com)

## **Ansprechpartner für die Presse:**

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

## **Herausgegeben durch:**

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

E-mail: [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)